

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/078034 A1

(51) 国際特許分類⁷: C09J 163/00, 9/02, H01B 1/22

〒4488661 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内 Aichi (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001941

(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 9 日 (09.02.2005)

(74) 代理人: 宮崎 昭夫, 外(MIYAZAKI, Teruo et al.); 〒1070052 東京都港区赤坂 1 丁目 9 番 2 0 号 第 1 6 興和ビル 8 階 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-036213 2004 年 2 月 13 日 (13.02.2004) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ハリマ化成株式会社 (HARIMA CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒6570019 兵庫県加古川市野口町水足 6 7 1 番地の 4 Hyogo (JP). 株式会社デンソー (DENSO CORPORATION) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 Aichi (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 寺田 信人 (TERADA, Nobuto) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 9 番の 3 ハリマ化成株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 塩井 直人 (SHIOI, Naoto) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台 5 丁目 9 番の 3 ハリマ化成株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 都外川 真志 (TOTOKAWA, Masashi) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内 Aichi (JP). 二宮 泰徳 (NINOMIYA, Yasunori) [JP/JP];

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CONDUCTIVE ADHESIVE

(54) 発明の名称: 導電性接着剤

(57) Abstract: A conductive adhesive that can be used as a substitute for solder welding to carry out surface mounting of electronic parts for vehicle loading purposes and to provide conductive junction forming means in the manufacturing of electronic parts per se. There is provided a conductive adhesive comprising a conductive medium, such as silver powder, dispersed in a binder resin component of one-pack epoxy thermosetting resin having a composition comprising, as essential components, an epoxy resin component composed mainly of an epoxy compound with polycyclic aromatic ring skeleton, a cyclic acid anhydride as a curing agent component thereof and a coupling agent as an adherence imparting agent.

(57) 要約: 本発明は、車載用の電子部品の表面実装、電子部品自体の作製における導電性接合形成手段として、ハンダ接合の代替として利用可能な導電性接着剤を提供する。本発明にかかる導電性接着剤は、必須成分として、多環式芳香環骨格を有するエポキシ化合物を主成分とするエポキシ樹脂成分と、その硬化剤成分として、環状酸無水物を含み、さらに、密着性付与剤として、カップリング剤を添加してなる組成を有する一液性エポキシ系熱硬化性樹脂のバインダー樹脂成分中に、導電性媒体の銀粉等を分散してなる導電性接着剤である。

WO 2005/078034 A1